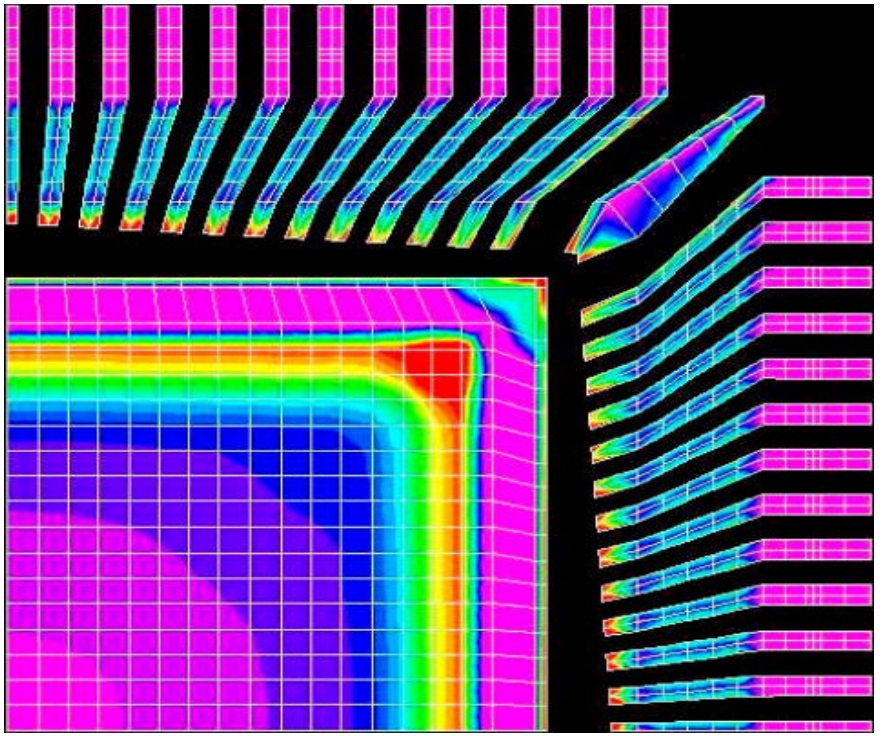
TCC

Top Chemical Company

PACKAGE TREND



TCC ADHESIVE TEAM

TCC
Top Chemical Company

반도체 PACKAGE의 정의

- 반도체 PACKAGE의 정의
  - 반도체 칩을 Substrate(Lead-frame, PCB:Printed Circuit Board)에 탑재하여 이 반도체 칩과 금선(Gold Wire)을 이용하여 전기적으로 연결해 주고, 외부의 습기나 불순물로부터 보호할 수 있게 EMC(Epoxy Molding Compound)라는 수지로 밀봉 포장하여 반도체로서 기능을 할 수 있게 해주는 기술을 반도체 패키징이라고 함.
    - 반도체 칩은 수 많은 미세 전기 회로가 집적되어 있으나 그 자체로는 반도체 완제품으로서의 역할을 할 수 없으며, 외부의 물리적, 화학적 충격에 의해 쉽게 손상될 수 있음.

- 반도체 PACKAGE의 조립 목적
  - 실용화
  - 동작 기능 보호
  - 전기적, 물리적 특성 및 목표 수명을 향상시킴
  - 반도체 Device를 기계적, 물리적, 화학적인 충격으로부터 보호
  - 신뢰도 및 접착도 유지

TCC
Top Chemical Company

ELECTRIC APPLIANCE TREND

Personal Computer		 
Telephone		
Video Tape Recorder		

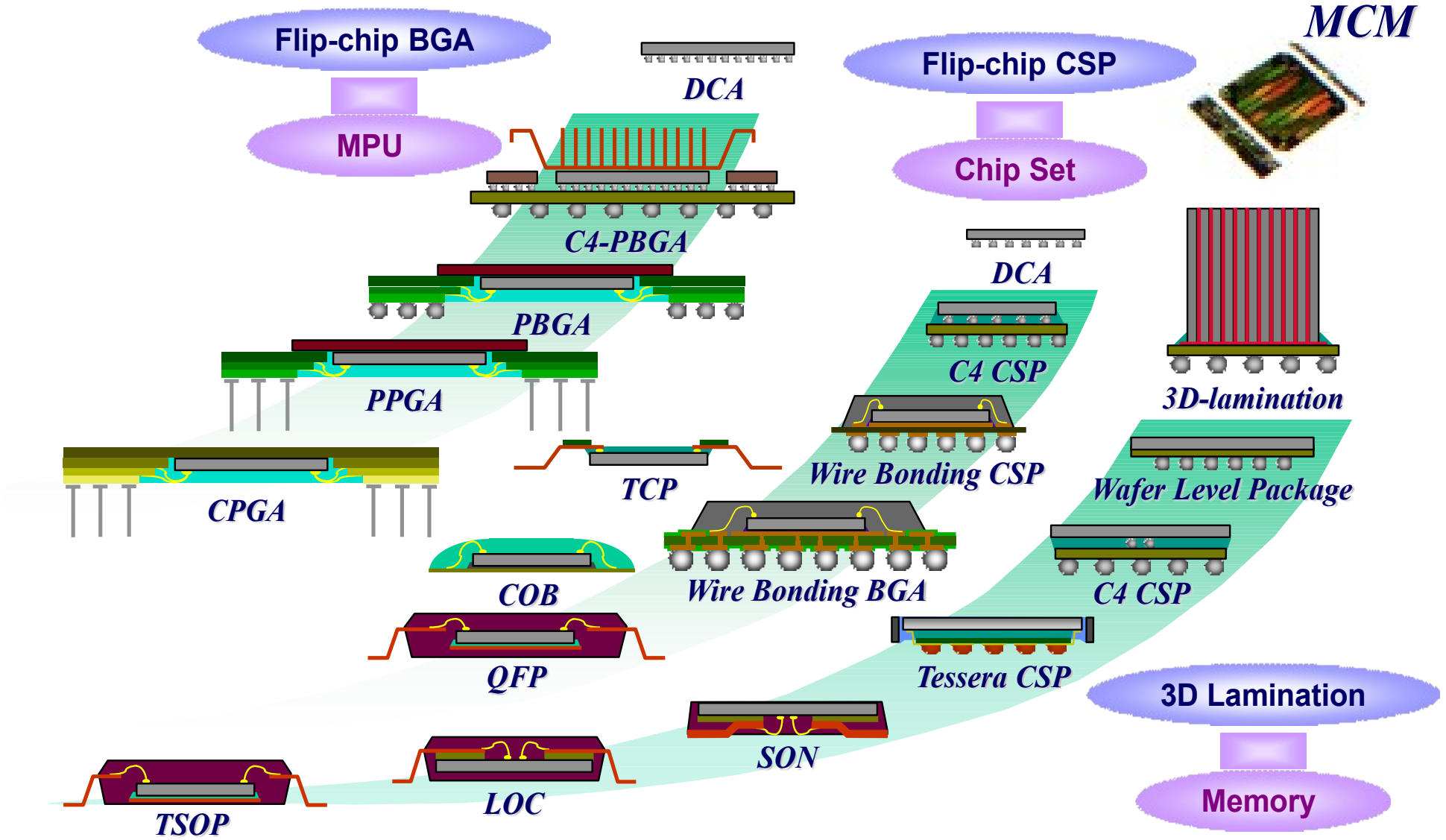
Multi Function
Small Size, Light Weight, Low Profile
High Performance

→

VLSI or System-LSI
High Performance Packaging
High Density Assembly

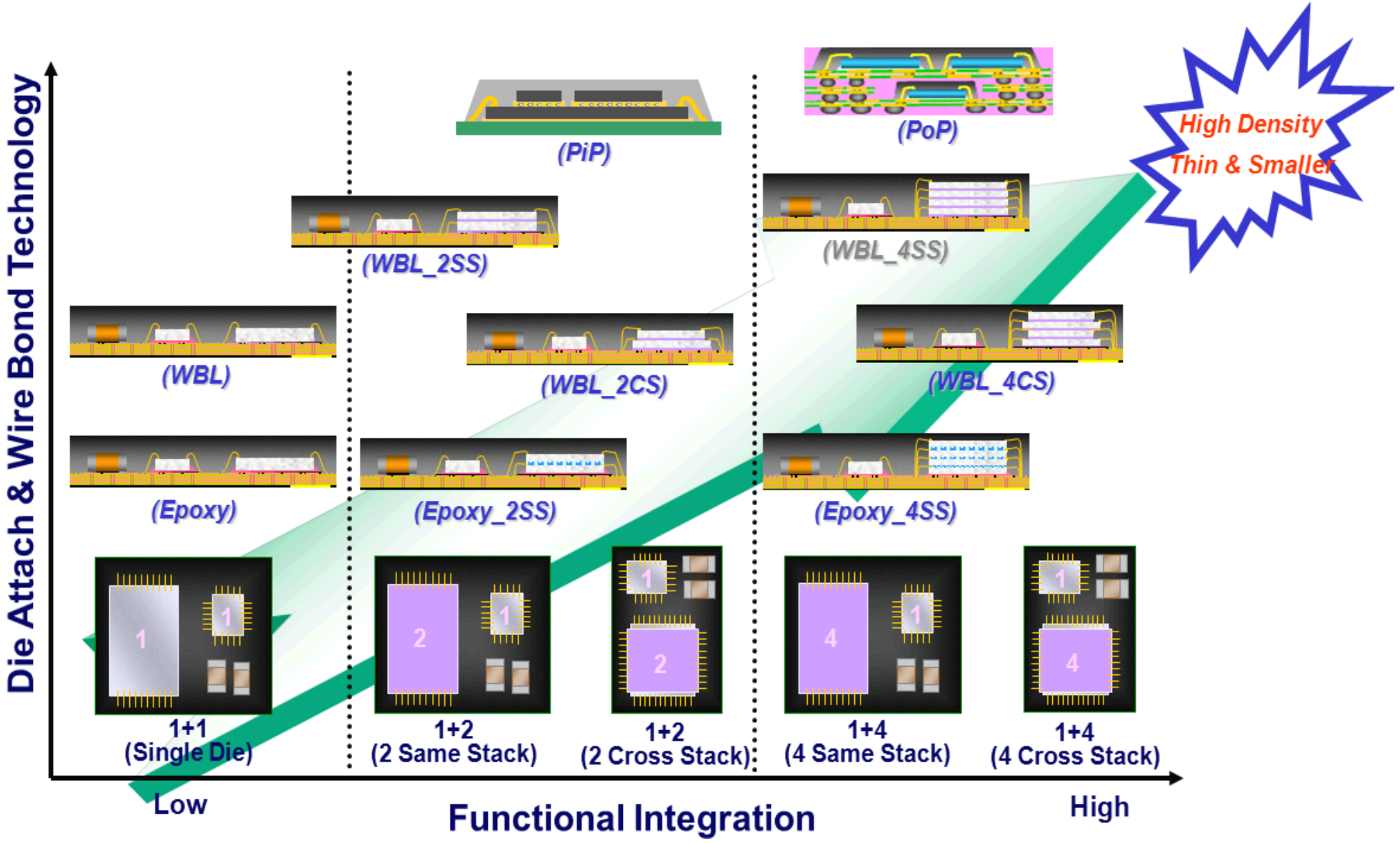
TCC
Top Chemical Company

PACKAGE TRAND - ALL PKG



TCC
Top Chemical Company

PACKAGE TRAND - SIP PKG



TCC
Top Chemical Company

PACKAGE TRAND - PKG TECHNICAL TRAND

